

Procedure file

Informations de base	
DEA - Procédure d'acte délégué	2013/2905(DEA)
Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur	
Exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de raccordement des fils et des câbles et les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une température inférieure à ? 20 °C	
Complétant 2008/0240(COD)	
Sujet	
3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique	
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)	

Acteurs principaux			
Parlement européen	Commission au fond	Rapporteur(e)	Date de nomination
	ENVI Environnement, santé publique et sécurité alimentaire		

Evénements clés			
18/10/2013	Publication du document de base non-législatif	C(2013)06798	
18/10/2013	Période initiale pour l'examen de l'acte délégué 2 mois		
23/10/2013	Annonce en plénière de la saisine de la commission		
19/12/2013	Pas d'opposition à l'acte délégué par le Conseil		
07/01/2014	Pas d'opposition à l'acte délégué par le Parlement		

Informations techniques	
Référence de procédure	2013/2905(DEA)
Type de procédure	DEA - Procédure d'acte délégué
Sous-type de procédure	Examen d'un acte délégué
Etape de la procédure	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
Dossier de la commission parlementaire	ENVI/7/14364

Portail de documentation
